

Title (en)  
METHOD FOR OBTAINING COATINGS ON PARTS.

Title (de)  
VERFAHREN ZUR BESCHICHTUNG VON TEILEN.

Title (fr)  
PROCEDE POUR L'ENROBAGE DES PIECES.

Publication  
**EP 0304488 A1 19890301 (DE)**

Application  
**EP 87903473 A 19870311**

Priority  
SU 8700028 W 19870311

Abstract (en)  
A method for obtaining coatings on parts provides for applying to the surface of a part (1) a material of the coating (2). The part (1) with the coating (2) is then inserted in a refractory material (4) which is consolidated for securing the part (1) and in which the melting of the coating (2) is effected. Then the part (1) is kept under that melting temperature until an intermediate diffusion zone between the materials of the coating (2) and of the part (1) is obtained. The cooling is effected inside the refractory material (4) until crystallization of the material of the coating (2).

Abstract (fr)  
Un procédé pour l'enrobage des pièces consiste à appliquer à la surface d'une pièce (1) un matériau d'enrobage (2). La pièce (1) revêtue de l'enrobage (2) est ensuite introduite dans un matériau réfractaire (4) qui est compacté afin de maintenir la pièce (1) et dans lequel on effectue la fusion dudit enrobage (2). La pièce (1) est maintenue à ladite température de fusion jusqu'à ce qu'une zone de diffusion intermédiaire soit obtenue entre le matériau d'enrobage (2) et celui de la pièce (1). Le refroidissement est réalisé à l'intérieur du matériau réfractaire (4) jusqu'à l'obtention de la cristallisation du matériau d'enrobage (2).

IPC 1-7  
**C23C 4/14; C23C 4/18**

IPC 8 full level  
**C23C 4/04** (2006.01); **C23C 4/12** (2006.01); **C23C 4/18** (2006.01); **C23C 26/02** (2006.01)

CPC (source: EP)  
**C23C 4/18** (2013.01); **C23C 26/02** (2013.01)

Cited by  
DE19520149B4; DE19520149A1

Designated contracting state (EPC)  
AT BE CH DE FR GB IT LI NL SE

DOCDB simple family (publication)  
**WO 8807094 A1 19880922**; BR 8707695 A 19891031; EP 0304488 A1 19890301; EP 0304488 A4 19890926; JP H01502595 A 19890907

DOCDB simple family (application)  
**SU 8700028 W 19870311**; BR 8707695 A 19870311; EP 87903473 A 19870311; JP 50326987 A 19870311